

經濟部對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
114年度截至第1季止

單位: 元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額(含累積金額)	備註
公務預算							
1	經濟部產業技術司	新北市	其陽科技股份有限公司	高運算密度AI節能HPC技術開發計畫	114.1.17	54,000,000	
2	經濟部產業技術司	臺北市	廣運機械股份有限公司	高運算密度AI節能HPC技術開發計畫	114.1.17	19,412,000	
3	經濟部產業技術司	新北市	一詮精密工業股份有限公司	高運算密度AI節能HPC技術開發計畫	114.1.17	16,588,000	
4	經濟部產業技術司	桃園市	穩懋半導體股份有限公司	矽光子共同封裝光學之高功率光源關鍵技術開發計畫	114.1.17	43,000,000	
5	經濟部產業技術司	高雄市	康聚醫學科技股份有限公司	可降解鎂合金血管夾開發計畫	114.1.17	13,200,000	
6	經濟部產業技術司	彰化縣	長鴻醫材科技股份有限公司	可降解鎂合金血管夾開發計畫	114.1.17	13,200,000	
7	經濟部產業技術司	高雄市	安鍊佳科技股份有限公司	可降解鎂合金血管夾開發計畫	114.1.17	5,600,000	
8	經濟部產業技術司	臺中市	濰元科技股份有限公司	低功耗便攜式低軌衛星地面收發射頻前端模組開發計畫	114.3.7	7,800,000	
9	經濟部產業技術司	新竹市	上詮光纖通信股份有限公司	應用於雲端AI/HPC之光連結中光纖耦合陣列暨封測整合系統開發計畫	114.3.7	36,000,000	
10	經濟部產業技術司	臺北市	立普思股份有限公司	3D機器視覺邊緣加速器跨平台應用系統研發計畫	114.3.28	26,640,000	
11	經濟部產業技術司	臺北市	博唯弘展生技股份有限公司	單劑液型溫感噴霧式術後防組織沾黏水膠開發計畫	114.3.28	22,566,000	
12	經濟部產業技術司	高雄市	東台精機股份有限公司	應用於AI伺服器之PCB背鑽精度與技術躍升計畫	114.3.28	26,433,000	
13	經濟部產業技術司	桃園市	得力富企業股份有限公司	應用於AI伺服器之PCB背鑽精度與技術躍升計畫	114.3.28	11,567,000	
14	經濟部產業技術司	新竹縣	漢磊科技股份有限公司	電動車高功率高效能低導通阻抗平面型碳化矽技術開發計畫	114.3.28	44,892,000	
15	經濟部產業技術司	新北市	尼克森微電子股份有限公司	電動車高功率高效能低導通阻抗平面型碳化矽技術開發計畫	114.3.28	13,108,000	
16	經濟部產業技術司	臺南市	大員生醫股份有限公司	大員油(T-ACE Oil)以肝動脈栓塞或肝動脈化學栓塞療法(TAE/TACE)用於肝細胞癌(HCC)病人之第II期臨床試驗計畫	114.1.21	14,800,000	
17	經濟部產業技術司	臺中市	長聖國際生技股份有限公司	以同種異體嵌合抗原受體(CAR) Gamma-Delta T 細胞CAR001 在復發/難治型實體腫瘤患者之Phase I 臨床試驗計畫	114.2.3	51,485,000	
18	經濟部產業技術司	臺北市	台灣百應生物科技股份有限公司	智慧家禽 AI Camera – 邊緣運算及 AI 供需優化系統計畫	114.3.7	29,493,940	
公務預算 合計						449,784,940	

備註：「核准日期」及「補(捐)助金額(含累積金額)」係指補(捐)助案件之核定日期及核定金額。